

ウエーハの**高品質化ニーズ**に対応する

『W-GMシリーズ』が話題！

東精エンジニアリング



W-GM-5200

高品質化が求められている。

同社では、こうしたニーズに対応してウエーハの面取機「W-GMシリ

ウエーハのエッジ部を高精度に面取りする

ーズ」を開発し、更なる性能向上を進めている。

面取機ではトップシェアを誇り、全世界の量産工場で採用されている同機を利用することにより、ウエーハのエッジを高精度に面取りすることが可能。信頼性の高い半導体づくりに貢献する。

シリコンやサファイア、SiCなど多岐にわたる素材のウエーハの加工が可能。タッチパネルで操作できる取り扱いやすさと相まってシリコンメーカーのみならず化合物半導体、酸化物材料メーカーなど幅広い分野で豊富な導入実績を誇っている。

東精エンジニアリング（茨城県土浦市東中貫町四一六、☎〇二九一八三〇一八八八）は、昨年の十二月十四日～十六日まで東京ビッグサイトで開催された「セミコンジヤパン」で、ウエーハの面取り機「W-GMシリーズ」を紹介し、注目を集めた。

必要不可欠なプロセスとなっており、近年ではウエーハの品質向上のニーズが高まっている。特に最先端向けのウエーハでは、エッジの品質が重要で、より厳しいスペックを安定して供給する必要が高い。また、デバイスウエーハの製造工程でエッジ起因によるウエーハの歩留り低下が発生することからウエーハのエッジ部の加工状態の

プされる「W-GM-5200」は、2つの加工ステージを有する2軸機面取機。12インチのウエーハに対応するベストセラーマシンである。

対応ワークは、シリコン、サファイア、SiC、GaN、LT、L N、GaAs、ガラス、セラミックス、各種化合物、各種結晶材料、各種物、各種材料。

加工効率も2つの加工

ng.co.jp/

http://www.toseie



同社の外観風景